

公司代码：600584

公司简称：长电科技

江苏长电科技股份有限公司  
2025 年年度报告摘要



## 第一节 重要提示

- 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3、 公司全体董事出席董事会会议。
- 4、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司拟以总股本1,789,414,570股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配红利178,941,457.00元（含税），分配后公司未分配利润结余转入下一年度。2025年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述利润分配预案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需经公司2025年年度股东会审议批准后实施。

经公司2024年年度股东大会授权、公司第八届董事会第十四次临时会议审议批准，公司已于2025年9月26日派发2025年中期现金红利53,682,437.10元（含税）。综上，公司2025年度拟合计派发现金红利232,623,894.10元（含税）。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

## 第二节 公司基本情况

### 1、 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长电科技	600584	G苏长电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁燕	卞晓霞
联系地址	江苏省江阴市滨江中路275号	江苏省江阴市滨江中路275号
电话	0510-86856061	0510-86856061
传真	0510-86199179	0510-86199179
电子信箱	IR@jcetglobal.com	IR@jcetglobal.com

## 2、报告期公司主要业务简介

公司所属行业为半导体芯片成品制造和测试子行业。半导体行业根据不同的产品分类主要包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类，广泛应用于通信类、高性能计算、消费类、汽车和工业等重要领域。其中，集成电路为整个半导体产业的核心，因为其技术的复杂性，产业结构具备高度专业化的特征，可细分为集成电路设计、集成电路晶圆制造、集成电路芯片成品制造和测试三个子行业。

### (1) 半导体市场情况

2025 年，全球半导体行业总体呈现复苏态势。世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计数据，2025 年全球半导体销售额达到 7,956 亿美元，创历史新高。

从细分应用领域来看，生成式 AI、云计算、数据中心、高端服务器等相关需求持续高景气，推动逻辑芯片和存储器成为 2025 年增长最快的品类。相比之下，传统消费电子、部分工业与汽车相关的芯片需求复苏相对平稳。行业整体呈现 AI 相关需求高速增长与传统应用市场复苏并存的格局。

人工智能（AI）已成为半导体行业增长的核心驱动力之一。TrendForce 研究指出，在生成式 AI 持续落地与云服务商加大投入的带动下，2025 年全球 AI 服务器出货量同比增长约 25% - 30%。IDC 数据显示，AI 基础设施投资已进入持续高景气阶段，并持续向云计算、科研及企业级 AI 应用扩散。整体来看，AI 服务器市场正从“阶段性爆发”迈向“中长期高景气成长通道”，深刻重塑芯片、封装、存储及系统级集成的需求结构。

通信与计算机领域走势分化。Canalys 数据显示，2025 年全球智能手机出货量约 12.2 亿部，同比基本持平；2025 年全球台式机、笔记本电脑及工作站出货量实现中高个位数增长，商用设备的更新周期为市场复苏注入了关键动力，市场复苏态势相对更为清晰。

受全球汽车终端需求疲软、供应链持续去库存等因素影响，2025 年汽车半导体市场呈现低速增长态势，全球汽车半导体市场规模约 758.4 亿美元，同比增长 0.2%（数据来源：Omdia）。中国汽车市场增长表现优异，根据中国汽车工业协会统计，全年销量达到 3,440 万辆，同比增长 9.4%；其中新能源汽车销量 1,649 万辆，同比增长 28.2%。2026 年，随着汽车产业持续向电动化、智能化及网联化方向演进，高压平台、智能驾驶功能渗透率提升以及车载算力需求增加，预计汽车单车半导体价值量将继续上升。

从全球半导体产业发展的历史情况来看，半导体产业具有一定的周期性。



## （2）半导体行业上下游情况

集成电路产业链包括集成电路设计（含 EDA 工具和 IP 核）、集成电路晶圆制造、芯片成品制造和测试、设备和材料行业。公司所属芯片成品制造与测试位于产业链中下游，是集成电路产业链上重要的一个环节。集成电路芯片成品制造与测试的客户是集成电路设计公司和系统集成商，设计公司设计出芯片方案或系统集成方案，委托集成电路制造商生产晶圆（芯片），然后将芯片委托封测企业进行封装、测试等，再由上述客户将产品销售给电子终端产品组装厂。

集成电路芯片成品制造行业的供应商是设备和材料。原材料的供应影响芯片成品制造行业的生产，原材料价格的波动影响芯片成品制造行业的成本。

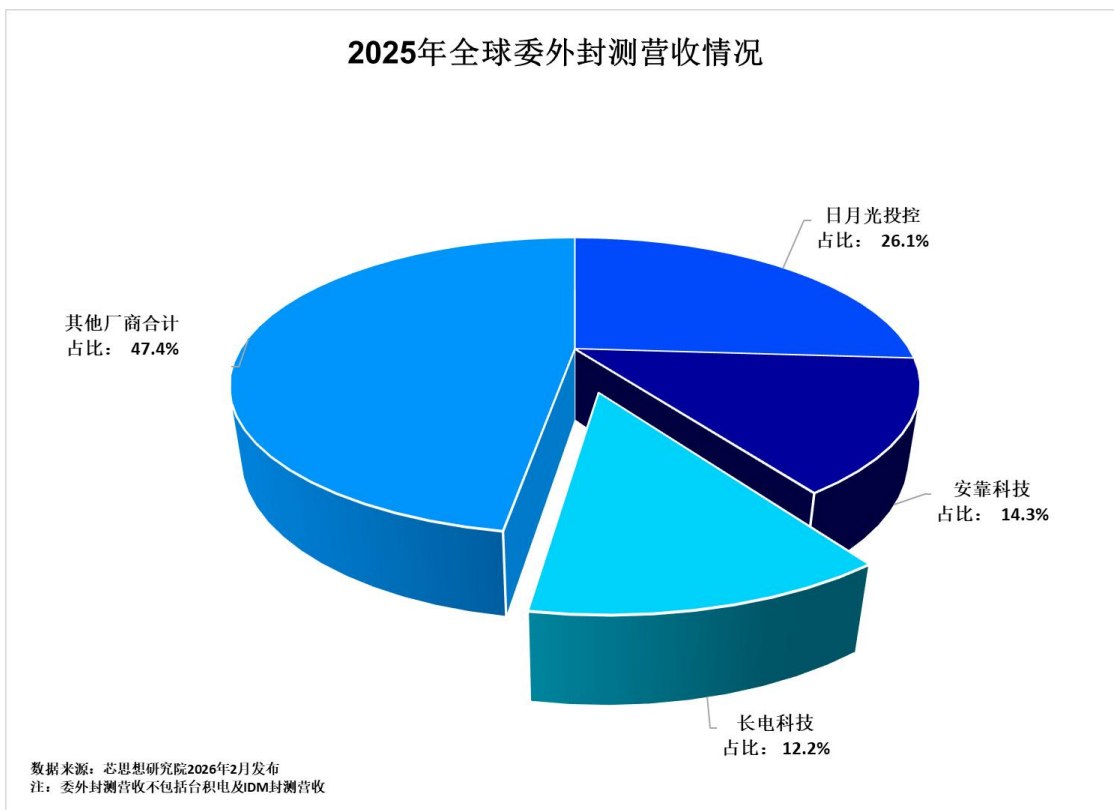
## （3）封装测试产业发展情况

2025 年，全球半导体封测市场在云计算和数据中心需求保持强劲、消费电子与汽车电子温和复苏的共同推动下，呈现结构性增长，市场规模创历史新高，技术结构持续向先进封装演进。

Yole Group 报告显示，2025 年全球先进封装市场规模约 531 亿美元。高性能芯片加速导入 2.5D/3D 封装，基板尺寸向 100mm×100mm 演进，基板层数持续增加，技术复杂度显著提升，推动产业从传统封装向先进封装加速转型。

芯思想研究院（ChipInsights）数据显示，2025 年全球委外封测营收达 3,332 亿元人民币，创历史新高。行业集中度维持高位，前三大 OSAT 厂商合计市占率超过 52%。其中长电科技继续位列全球第三位，中国大陆第一，在先进封装及高端应用领域的技术积累与规模优势进一步巩固。

公司在品牌领导力、多元化团队、国际化运营、技术能力、品质保障能力、生产规模、运营效率等方面具备明显领先优势。凭借在行业持续的创新，公司入选 Brand Finance “2025 全球半导体品牌价值 30 强”榜单，为中国大陆仅有的两家入选半导体企业之一。



## （4）报告期内公司业务情况

长电科技是全球领先的集成电路制造与技术服务提供商，向全球半导体客户提供全方位、一站式芯片成品制造解决方案，涵盖微系统集成、设计仿真、晶圆中测、芯片及器件封装、成品测试、产品认证以及全球直运等服务。公司在中国、韩国和新加坡拥有八大生产基地，并在全球设有 20 多个业务机构，为客户提供紧密的技术合作与高效的产业链支持。

长电科技拥有先进和全面的芯片成品制造技术，包括晶圆级封装（WLP）、2.5D/3D封装、系统级封装（SiP）、倒装芯片封装、引线键合封装及主流封装先进化解决方案，广泛应用于汽车电子、人工智能、高性能计算、高密度存储、网络通信、智能终端、工业与医疗、功率与能源等领域。

近年来，公司持续聚焦高性能封装技术高附加值应用，加速对汽车电子、高性能计算、存储、5G通信等高附加值市场的战略布局，主动推进传统业务的取舍，进一步优化产品结构，提升核心竞争力。公司2025年营业收入按市场应用领域划分情况：通讯电子占比36.4%、消费电子占比23.6%、运算电子占比21.3%、汽车电子占比9.6%、工业及医疗电子占比9.1%。其中，运算电子领域营收同比增长42.6%，工业及医疗电子领域同比增长40.6%，汽车电子领域营收同比增长31.7%，业务结构持续向高附加值和高成长性方向优化。

公司主要经营模式为根据客户订单及需求，按为客户定制的个性化标准或行业标准提供专业和系统的集成电路成品生产制造、测试以及全方位的端到端的一站式解决方案。报告期内，公司的经营模式未发生变化。

### 3、公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	55,516,503,601.44	54,059,828,326.10	2.69	42,579,471,835.65
归属于上市公司股东的净资产	28,671,164,117.07	27,618,582,589.14	3.81	26,065,635,116.80
营业收入	38,871,348,331.23	35,961,679,888.59	8.09	29,660,960,881.35
利润总额	1,738,293,696.95	1,648,906,851.98	5.42	1,522,240,843.74
归属于上市公司股东的净利润	1,565,238,036.45	1,609,575,410.92	-2.75	1,470,705,571.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,369,472,054.89	1,547,625,265.49	-11.51	1,322,571,351.51
经营活动产生的现金流量净额	4,652,212,168.20	5,834,047,323.92	-20.26	4,436,698,567.22
加权平均净资产收益率(%)	5.56	6.00	减少0.44个百分点	5.81
基本每股收益(元/股)	0.87	0.90	-3.33	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.87	0.90	-3.33	0.82

公司主要会计数据和财务指标的说明：

本报告期，公司积极应对国际环境和市场需求的变化，持续优化产能布局并加大先进工艺技术研发创新和量产落地。受国内市场需求回暖及国产半导体替代等因素拉动，国内工厂销售增长，带动公司整体收入增加；与此同时，受国际大宗商品价格大幅上升影响，部分原材料成本对毛利率构成较大压力，叠加新建工厂尚处于产品导入期和产能爬坡期，未形成大规模量产收入及财务费用有所上升，短期内利润表现承压。未来公司将进一步夯实降本增效措施，提升产能利用率，聚焦高毛利、高附加值产品，不断增强盈利能力。

## 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	9,335,146,486.99	9,270,077,569.34	10,063,748,622.38	10,202,375,652.52
归属于上市公司股东的净利润	203,363,562.72	267,421,705.14	482,963,225.04	611,489,543.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	193,070,976.37	244,495,374.08	346,111,260.94	585,794,443.50
经营活动产生的现金流量净额	1,144,458,791.99	1,194,397,435.95	1,353,823,196.09	959,532,744.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 4、 股东情况

## 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

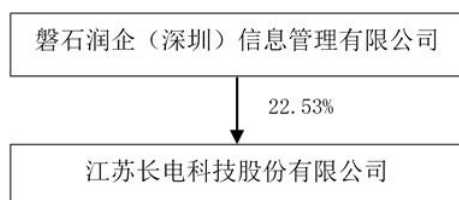
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					366,823		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					320,364		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
磐石润企（深圳）信息 管理有限公司	0	403,122,922	22.53	0	无		国有 法人
国家集成电路产业投资 基金股份有限公司	-1,756,480	60,852,500	3.40	0	无		国有 法人
香港中央结算有限公司	-45,039,295	47,097,312	2.63	0	无		其他
中国工商银行股份有限 公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数 证券投资基金	-915,118	23,706,783	1.32	0	无		其他
中国建设银行股份有限 公司—华夏国证半导体 芯片交易型开放式指数 证券投资基金	-8,171,100	18,088,459	1.01	0	无		其他

中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	-175,686	16,884,946	0.94	0	无	其他
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	1,531,200	12,867,011	0.72	0	无	其他
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	361,100	11,097,639	0.62	0	无	其他
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	3,407,800	9,017,893	0.50	0	无	其他
国泰海通证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	-7,176,881	8,914,315	0.50	0	无	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	磐石润企（深圳）信息管理有限公司为公司控股股东，与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

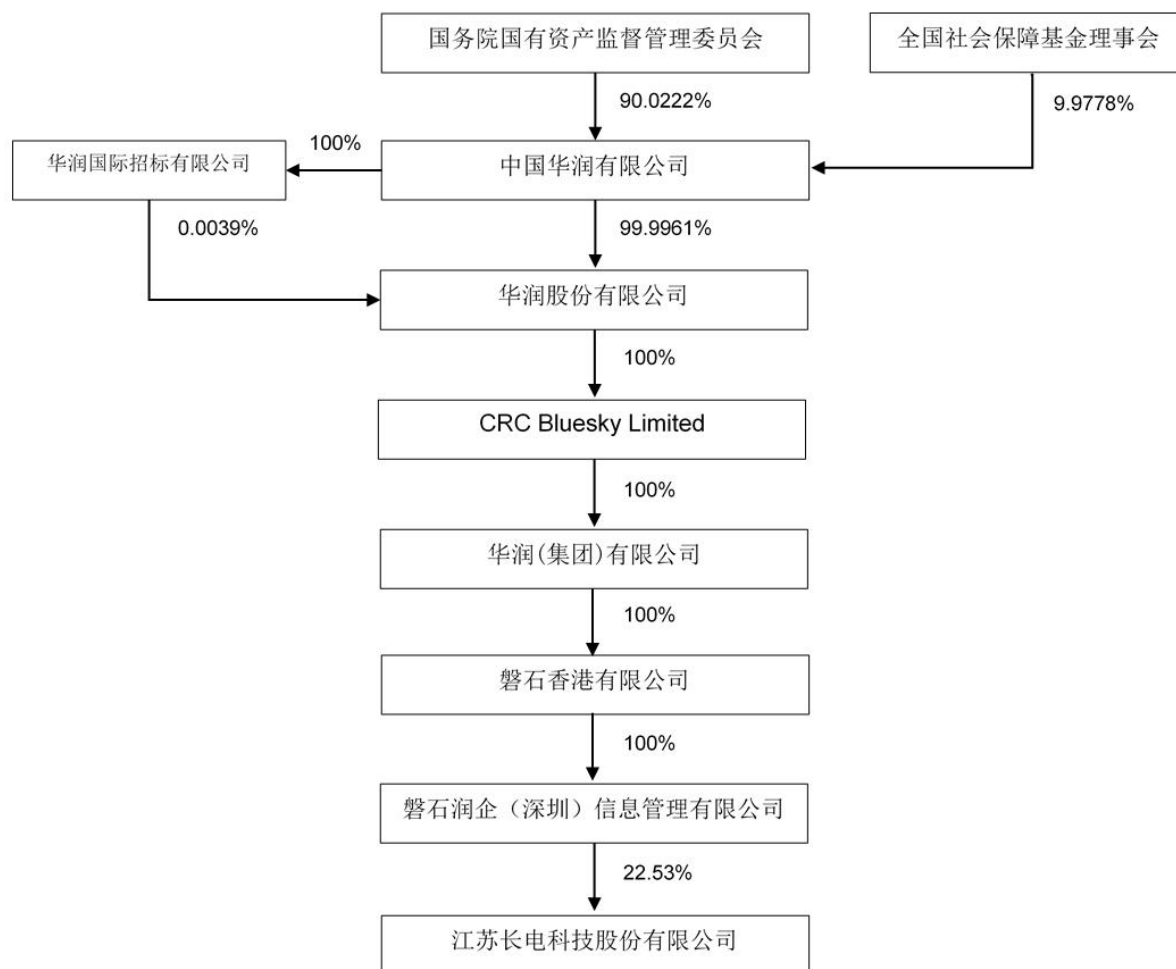
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

## 5、公司债券情况

√适用 □不适用

## 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
江苏长电科技股份有限公司2025年度第一期科技创新债券	25长电科技MTN001(科创债)	102585359	2035-12-26	2,400,000,000	2

## 5.2 报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

### 5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

### 5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

## 第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

1) 2025年，公司实现营业收入人民币388.71亿元，同比增长8.09%；利润总额人民币17.38亿元，同比增长5.42%；主营业务毛利率13.95%，同比增加1.07个百分点。公司研发投入20.86亿元，同比增长21.37%，为先进封装、系统集成等核心技术能力建设夯实基础。

报告期，公司围绕“结构性降本与风险可控”目标，通过强化全过程、可追溯的成本管控，实施差异化备料和库存清理激励机制，持续降低库存风险和资金占用；通过集中采购、策略协同和供应链联动等方式，对冲材料成本上行压力，稳步优化成本结构；同时，系统推进预算管理体系建设，将年度关键目标分解并通过月度滚动预测和经营分析机制，对收入、毛利率、现金流及主要风险指标进行动态监控，以实现成本结构优化与各环节协同增效。

2) 2025年半年度，公司以总股本1,789,414,570股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共分配红利53,682,437.10元（含税），分配后公司未分配利润结余转入下一期间，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次权益分派方案经公司2024年年度股东大会授权，并经第八届董事会第十四次临时会议审议通过，于2025年9月26日实施完毕。具体内容详见公司于2025年9月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏长电科技股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告》（临2025-044）。

3) 经公司第八届董事会第五次临时会议决议，同意由全资子公司长电科技管理有限公司以现金方式收购SANDISK CHINA LIMITED持有的晟碟半导体（上海）有限公司（以下简称“晟碟半导体”）80%的股权，交易对价以北京亚太联华资产评估有限公司出具的“亚评报字（2024）第45号”评估报告为依据，由交易双方协商确定约62,400万美元（最终价格根据交割前后的现金、负债和净营运资金等情况进行惯常的交割调整）。交易双方于2024年9月28日完成交割，晟碟半导体成为公司的间接控股子公司，并根据签署的相关协议分别于2024年9月30日、2025年1月6日、2025年9月29日支付了第一、第二、第三笔收购款。具体内容详见公司分别于2025年1月8日、2025年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏长电科技股份有限公司关于收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权的进展公告》（临2025-001）、（临2025-045）。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

江苏长电科技股份有限公司

董事长：周响华

2026年4月8日